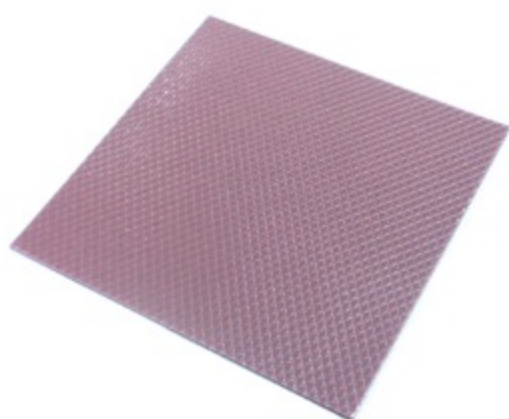


α-オレフィン系材料を使用しており、従来のシリコーン系材料で懸念されていた低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害を引き起こしません。



製品カタログはこちら

型番	WW-SF-B05
熱伝導率	2.0W/m・K
使用温度範囲	-40℃～110℃
JANコード	4524945012004
寸法	100mm×100mm×厚さ0.5mm

仕様	<p>ベースポリマー α-オレフィン 硬さ 35 (JIS Type E) 比重 1.8 体積抵抗値 $\geq 1 \times 10^{10}$ の10乗 ($\Omega \cdot \text{cm}$) 絶縁破壊電圧 ≥ 10 (AC kV/mm) 耐電圧 ≥ 10 (AC kV/mm) 難燃性 V-0 (UL94) 片面粘着、シリコーンフリー RoHS 2.0適合 絶縁性 本製品はCEマークは取得されておられません。</p>
----	--

製品PR	<ul style="list-style-type: none"> 発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。(熱源と放熱体の間に挟んで使用します。) 発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)とのすきま(ギャップ)や凹凸を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。 熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。また、難燃性を有し、作業性・加工性に優れた放熱シートです。 柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。 復帰性が良好でリワーク性に優れます。
------	--

備考	<p><u>低分子シロキサン電気接点障害とは</u> 従来のシリコーン系材料では、発熱体の動作熱により低分子シロキサンが発生し、電気接点障害を誘発することがあります。 誘発する例としましては、リレーの接点不良が多く、密閉された環境下でシリコーンを使用していると、シロキサンが発生し、リレー接点上に付着します。特にON/OFF回数の多いリレーは接点のON/OFFを繰り返すことにより、接点上に付着したシロキサンを酸化分解させ、二酸化ケイ素(SiO₂)となり、電気絶縁物として接点障害を引き起こします。</p>
----	--